



# 科建國際：驅動AI與太空經濟的關鍵技術核心

2026年法人說明會

## ◆ 免責聲明

- 本簡報及同時發佈之相關訊息所提及之前瞻性資訊，係本公司基於公司資料及盱衡整體經濟發展現況所得之資訊
- 此類前瞻性資訊將受風險、不確定性等原因所影響，部份將超出我們的控制之外，實際結果可能與這些前瞻性資訊大不相同。其原因可能來自於各種因素以及其他非本公司所能控制之風險等因素在內
- 本簡報資料中所提供之資訊並未明示或暗示性地表達或保證其具有正確性、完整性、或可靠性，亦不代表本公司、產業狀況或後續重大發展的完整性述論。僅表示對未來的展望，反應本公司截至目前為止對於未來的看法。對於這些看法，未來若有任何變更或調整時，(本公司)並不保證本簡報資料之正確性，且不負有更新或修正本簡報資料內容之責任
- 此簡報及其內容未經本公司書面許可，任何第三者不得任意取用

## ◆ 簡報大綱

01

### 我們是誰

公司基本盤、組織與產能條件

02

### 里程碑

關鍵發展、專利與客戶導入歷程

03

### 一站式解決方案

五大核心服務介紹與核心優勢

04

### 我們在產業鏈哪裡

半導體與新興應用的供應鏈定位

05

### 向上成長的引擎

未來發展動能與策略藍圖

06

### 總結與Q&A

交流時間



# ◆ 公司簡介



## 公司概況

2005年成立  
資本額 NTD 2.49億



## 組織規模

員工人數 140+  
CNC設備+檢測設備 100台+



## 廠區配置

總樓地板面積 6,620 m<sup>2</sup> (2,000坪)  
空調恆溫恆濕廠房、半導體等級無塵室

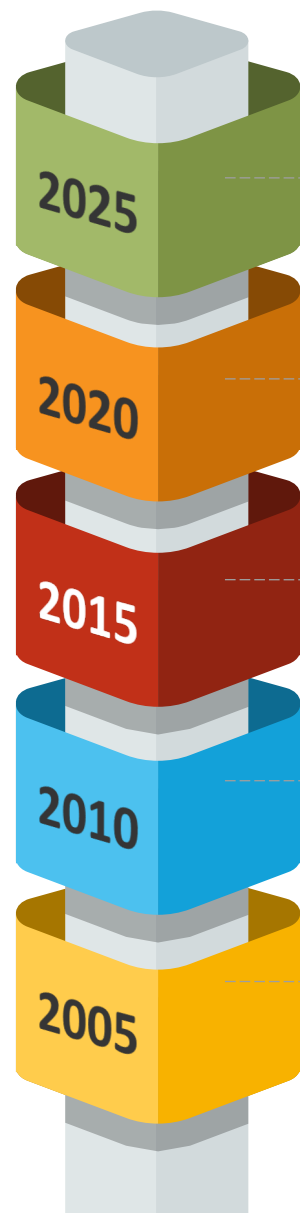


## 服務特色

高精密度、高潔淨度、高自製率  
一站式解決方案



## ◆ 發展沿革與里程碑



### 2025-Now



成功取得聯電12吋晶圓研磨環 (CMP Ring) 訂單  
取得國內IC晶片測試分選機龍頭  
大廠之關鍵零組件認證

### 2015-2018



2015Y：成功導入台積電晶圓研磨環 (CMP Ring) 供應鏈  
2018Y：取得美商應材(AMAT)新品及  
維修品認證並成為全球策略合作夥伴

### 2005-2008



2005Y：公司成立  
2005Y~2008Y：取得台積電、聯  
電、美光、南亞科、力積電、旺宏、  
世界先進等國內外半導體大廠合格  
供應商認證資格

### 2020-2024



2020Y：發明MNS arm並申請多國  
專利並成功導入台積電、聯電等國內  
外半導體廠

2024Y：

1. 取得航太低軌衛星(LEO)昇達科  
關鍵零組件生產製造認證
2. 開發半導體TFE製程加酸系統成  
功導入台積電並成為全球台積電  
廠區BKM項目
3. 成功導入聯電8吋晶圓研磨環  
(CMP Ring) 供應鏈

### 2010-2014



2010Y：成功導入國內外半導體廠設  
備零組件維修服務認證

2014Y：

1. 成功導入半導體國外真空閥件大  
廠供應鏈
2. 成功導入台積電化學機械研磨製  
程的PVA Brush供應鏈

## ◆ 產品服務



### 關鍵耗材開發

依照半導體終端客戶及半導體設備商、航太低軌衛星大廠之需求，應用高精度加工機製造各式金屬及高分子工程塑膠關鍵零組件及耗材



### 設備維修服務

供應半導體客戶做設備維修服務且自行開發測試平台在廠內協助客戶做品質測試與保證



### 代理產品銷售

代理國外半導體知名品牌耗材產品，提供更具有優勢及創新技術的產品給半導體客戶做多元化的選擇



### 工程改善案

針對半導體機台效能提升、潔淨度提升、降低成本支出以及降低人員失誤提供一系列的工程解決方案

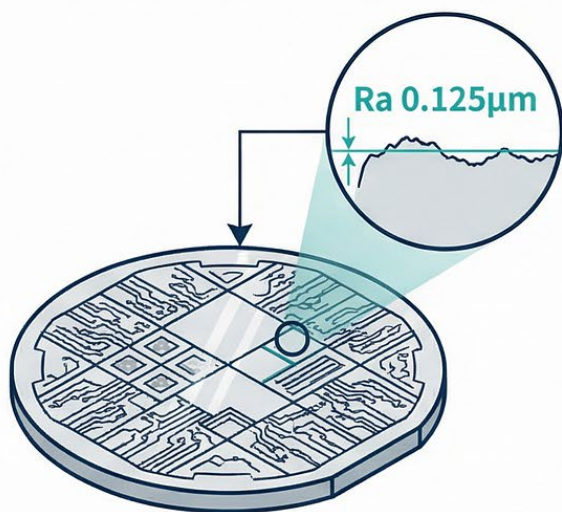


### 水資源處理

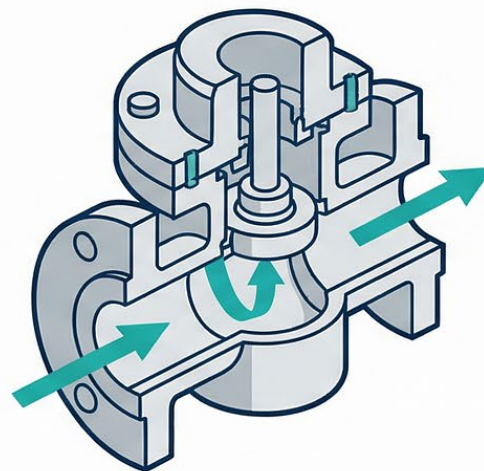
提供半導體、封裝封測廠或電子廠等客戶在生產過程中所製造的廢水廢液做特殊降解環保處理，符合ESG環境保護指標

## ◆ 核心優勢-解析半導體高階製程為何需要我們

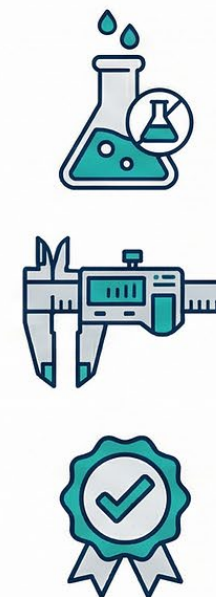
# 半導體製程對真空零件的嚴苛要求



超低表面粗糙度  
Ra 0.125µm以下



高純度閥體提升耐酸鹼性

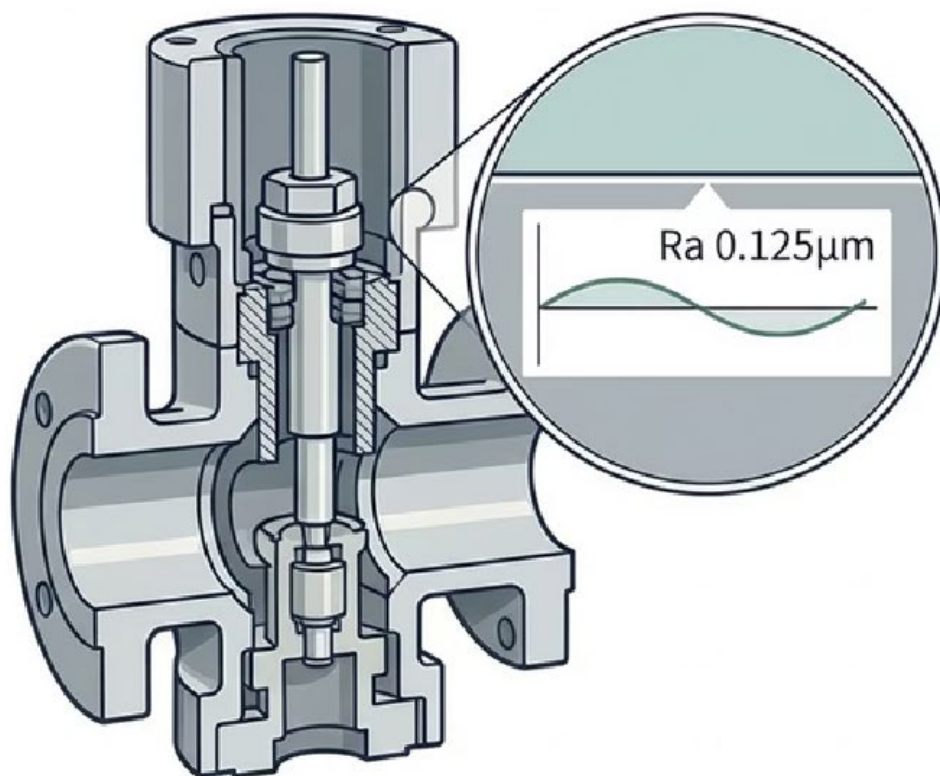


閥體符合最嚴格標準

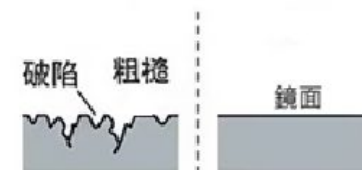


## ◆ 核心優勢-解析半導體高階製程為何需要我們

# 半導體高階製程閥體表面粗糙度與耐腐蝕性關聯



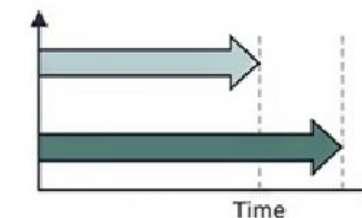
減少微觀缺陷  
降低腐蝕起點



流體順暢  
避免沉積堵塞



提升長期穩定性  
延長壽命

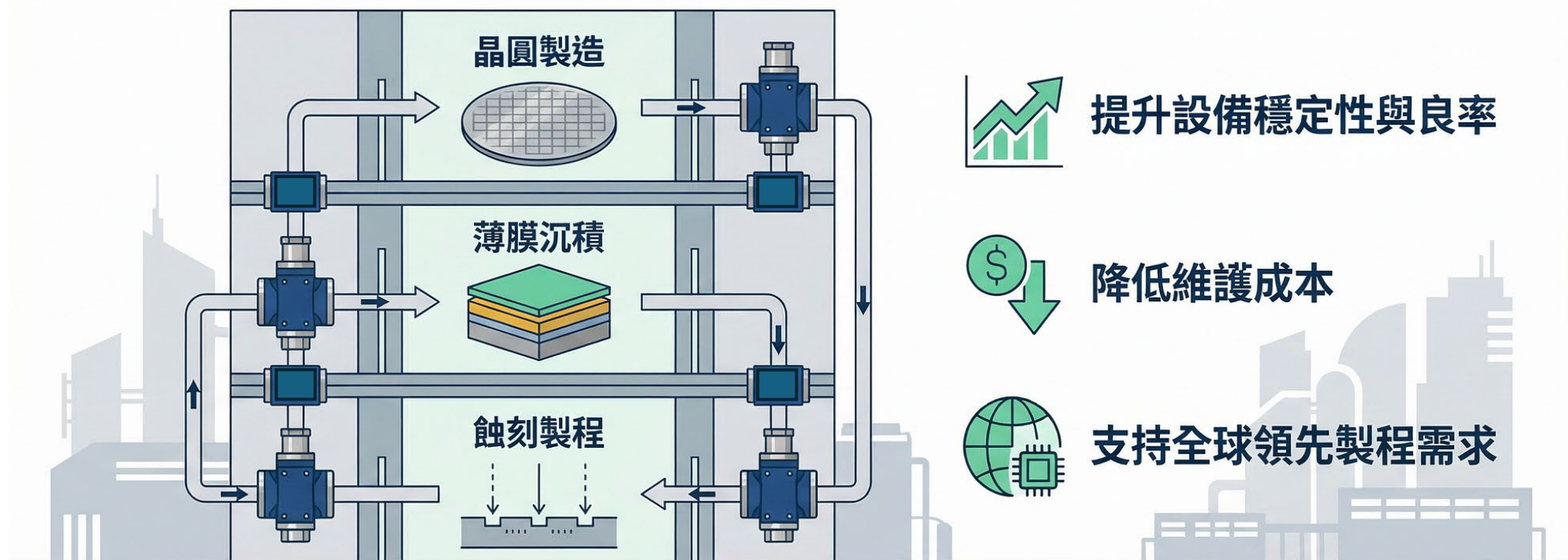


超低表面粗糙度 = 超高耐腐蝕性能



## ◆ 核心優勢-半導體高階製程針對閥體的應用總結

# 高階製程閥體在半導體製程設備中的應用價值

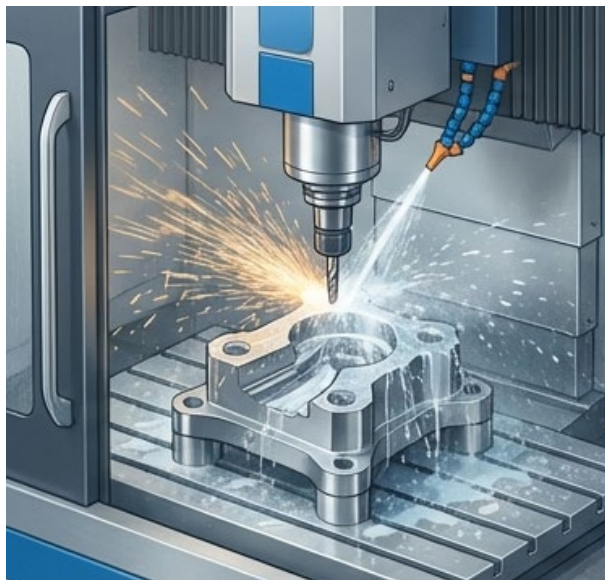


關鍵製程的可靠選擇

## ◆ 核心優勢

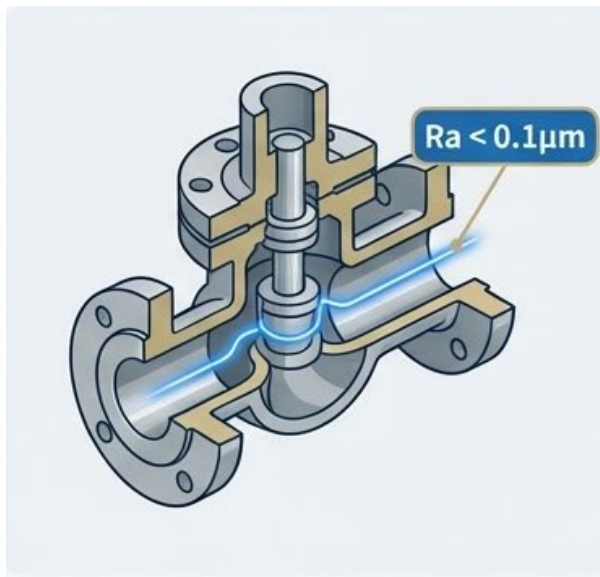
# 我們的技術護城河：三大核心優勢

本公司結合三大核心技術。為客戶提供無法輕易被取代的價值



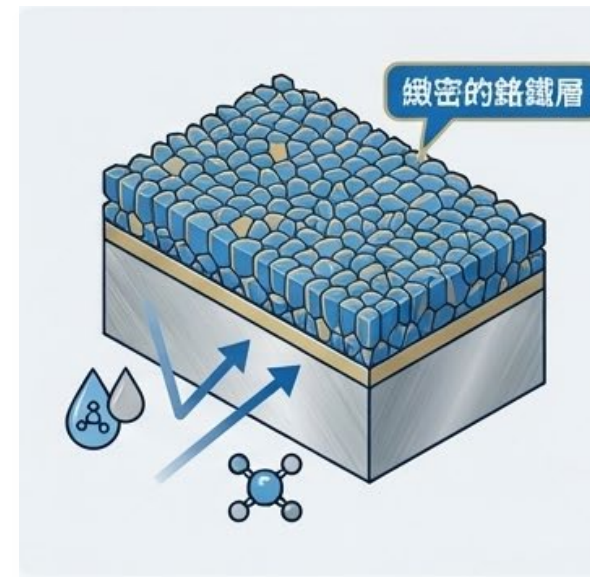
### 1. 高精密加工能力

擁有完善的先進精密加工機陣容，能處理高難度金屬與工程塑膠，以滿足半導體與航太低軌衛星產業的嚴苛公差要求



### 2. 獨特流道拋光技術

掌握閥體與腔體內部流道的精密拋光技術，使其表面粗糙度(Ra)達到 $<0.1\mu m$ 的業界頂尖水準，是先進製程潔淨度的關鍵需求

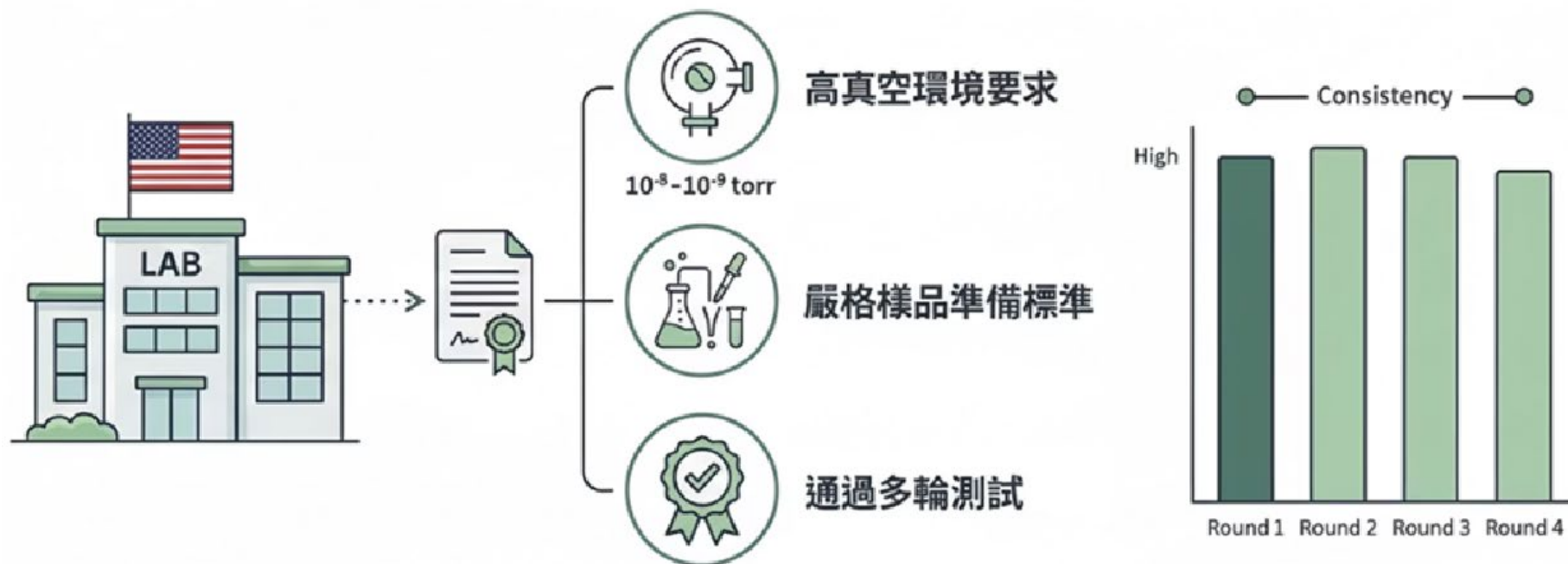


### 3. 特殊表面鈍化處理

針對316L潔淨鋼的獨家鈍化處理技術，能使關鍵零組件表面形成極緻密的鉻鐵層，可以抵抗高階半導體製程2nm以下的腐蝕性氣液體的侵蝕

## ◆ 核心優勢-目前我們正在做的事情

# 美國實驗室測試標準與閥體符合性



符合半導體產業最高標準 | 耐酸鹼 | 流體純淨度







# 乘上雙兆元浪潮： AI半導體與新太空經濟

科建國際正站在兩股無法逆轉的全球趨勢交會點上，  
驅動未來十年的成長。

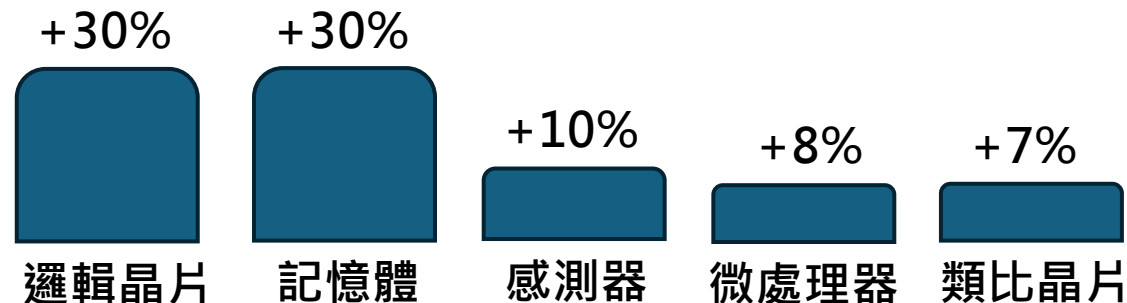
## ◆ 產業結構分析-半導體

### ➤ 2026年全球半導體市場規模預測



全球半導體市場即將突破1兆美元歷史里程碑，**Ai基礎建設投資持續爆發**  
科技巨擘資本支出從2023年1500億美元三倍成長至2026年超過5,000億美元

### ➤ 產業類別成長預測分析



**邏輯晶片與記憶體**為成長主力，受惠於Ai加速器、GPU高需求、HBM4量產與資料中心擴建

### ➤ 2026年台積電資本支出與擴廠計畫

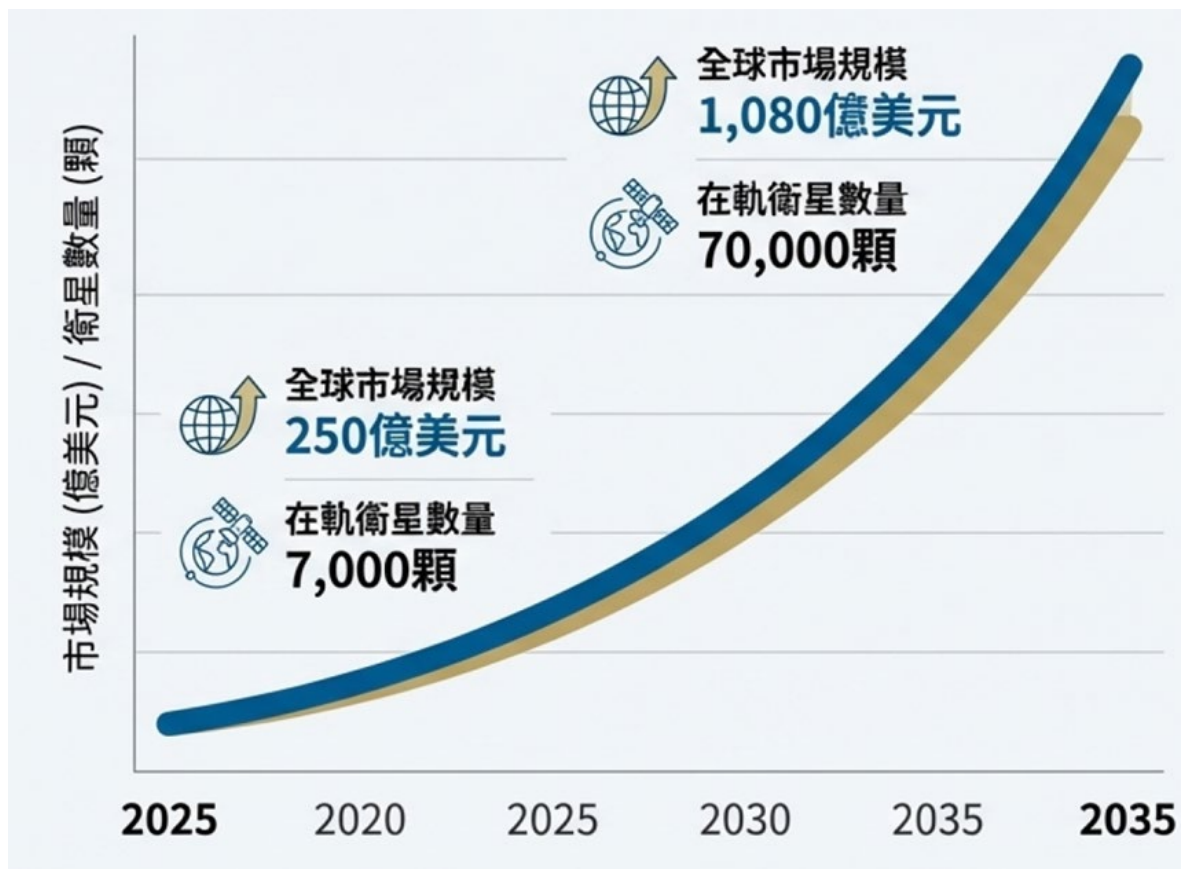




## ◆ 產業結構分析-低軌衛星

# 開拓新藍海：掌握低軌衛星(LEO)的巨大商機

除了半導體，我們已成功切入次世代通訊革命的核心供應鏈，具備航太等級的製造認證



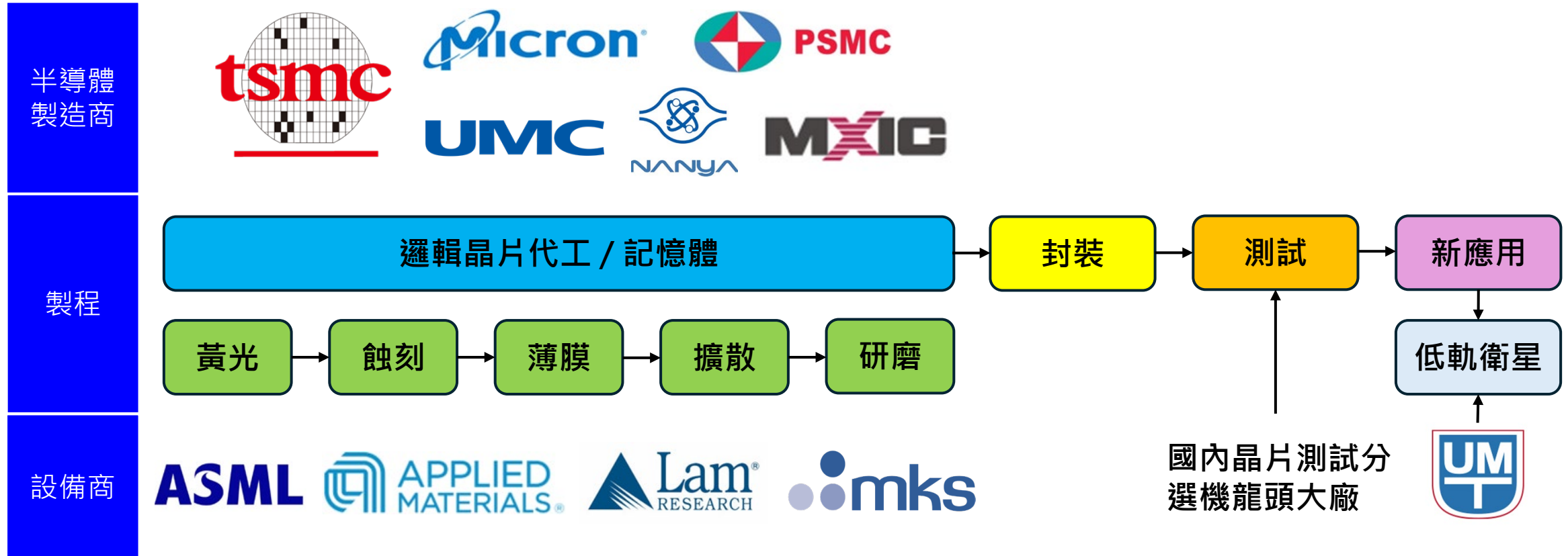
### 我們的角色：關鍵零組件製造商

-  衛星結構件
-  通訊模組外殼
-  熱控系統零件
-  姿態控制元件

輕量化高強度材料的超高精度加工技術及特殊表面處理技術正是我們科建的強項與優勢



# ◆ 我們的定位-從Ai晶片/記憶體至低軌衛星的供應鏈結構



從零件供應商到戰略合作夥伴，我們在客戶的成功中扮演不可或缺的角色

## ◆ 營收依產業別分佈概況

2025年上半年(H1)，半導體產業貢獻了79%的營收，是公司的核心業務，同時低軌衛星等新興業務展現強勁的成長動能

- **半導體 (Semiconductors) : 79%**

作為公司的核心業務，涵蓋了晶圓製造與封測的關鍵耗材及維修服務是營收與獲利的主要來源

- **低軌衛星 (Low-Earth Orbit Satellites) : 9%**

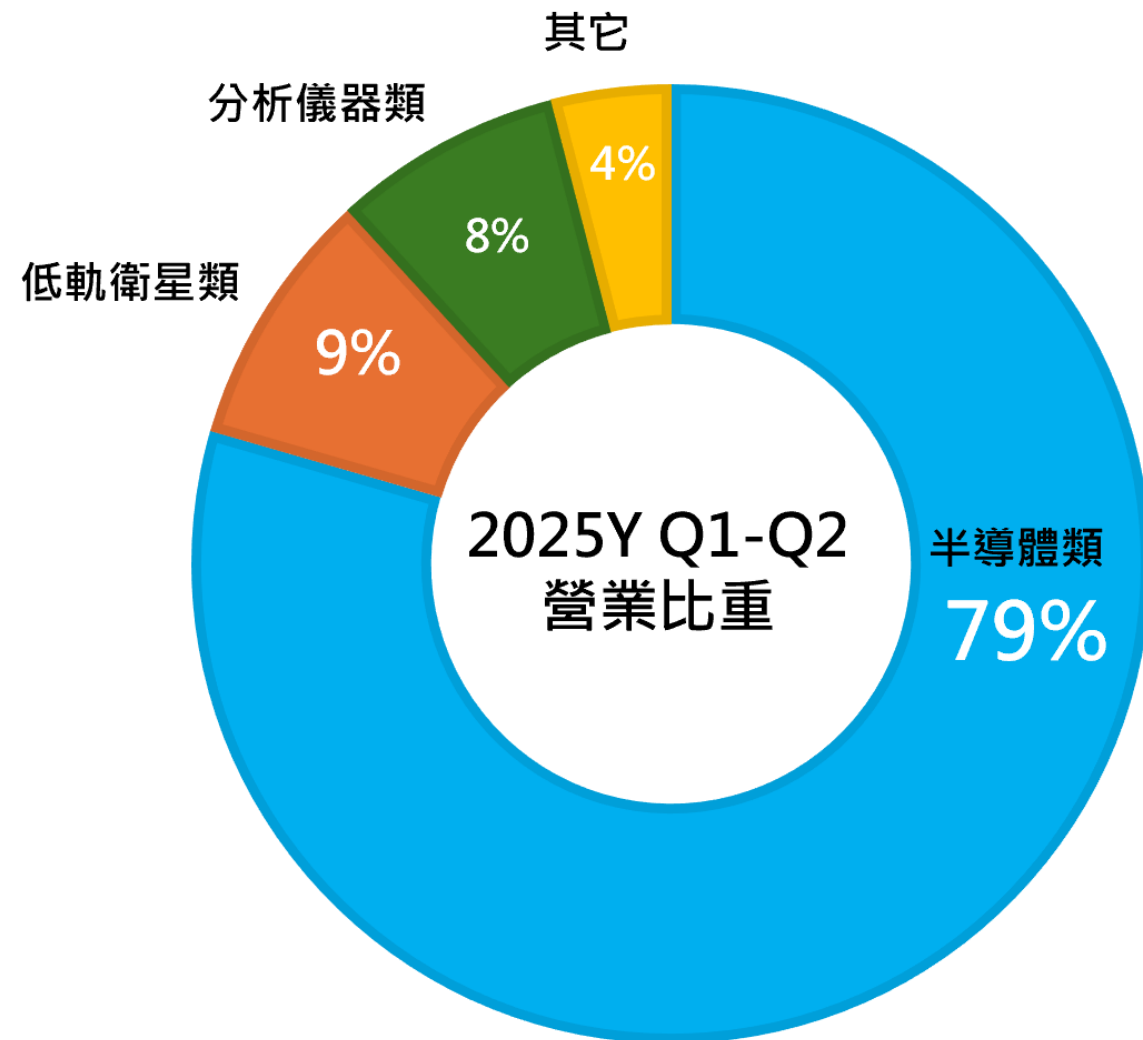
近年重點發展的新興業務，已成功切入供應鏈並開始貢獻營收，未來成長潛力巨大

- **分析儀器 (Analytical Instruments) : 8%**

提供國外大廠精密儀器所需的關鍵零組件，業務穩定

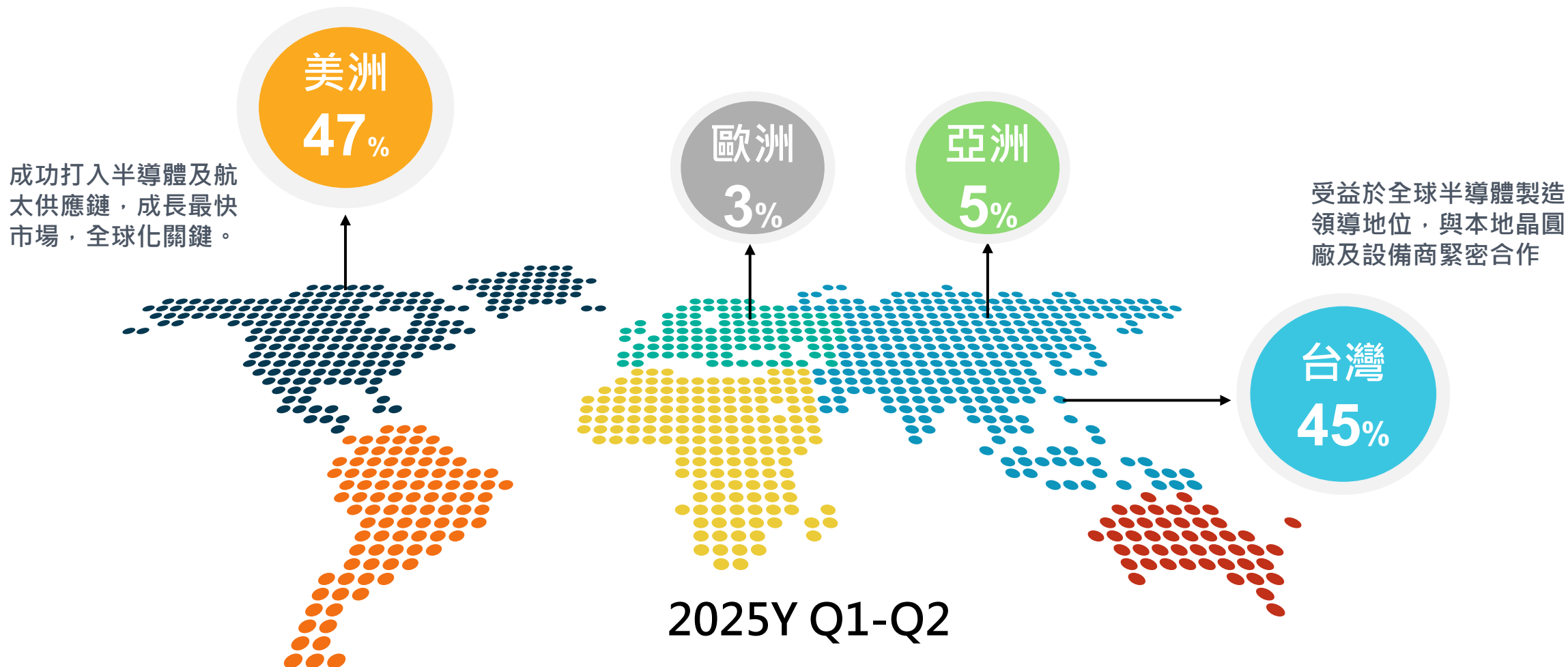
- **其他 (Others) : 4%**

包含其他利基市場的精密加工業務(自行車與醫療)



## ◆ 營收依銷售地區分佈概況

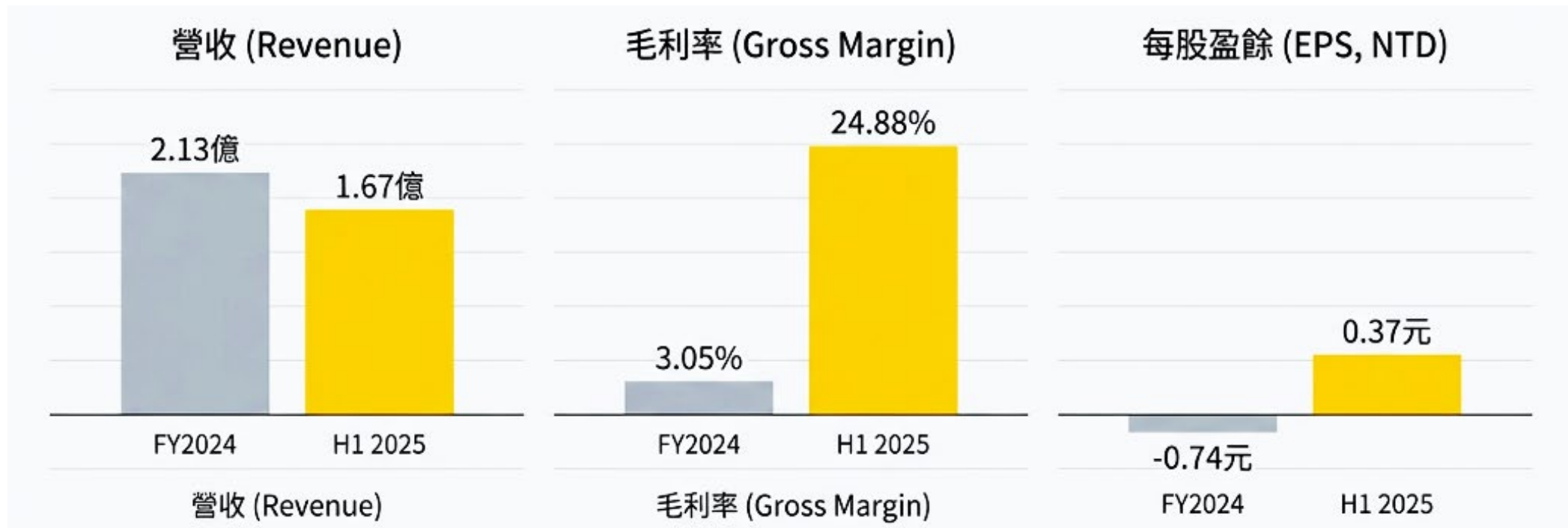
我們的營收市場高度集中於台灣及美洲，兩者合計佔比超過90%，反映了我們在全球半導體核心區域的深度佈局





## ◆ 財務表現

### 營運轉捩點：獲利能力與成長動能的展現



2025上半年，公司毛利率顯著提升至24.88%，並成功轉虧為盈。這證明了高毛利產品線的擴展與新業務的導入策略已見成效，公司正式進入成長與獲利的新階段

## ◆ 競爭優勢總結-我們的三大競爭護城河



### 1. 高黏著度的供應鏈角色

- 與台積電、AMAT、Micron等國際大廠建立長期夥伴關係
- 產品應用於關鍵製程，客戶轉換成本極高，等於形成強大進入障礙



### 2. 耗材+維修+新品的重複性營收

- 商業模式結合持續性(耗材)、穩定性(維修)、成長性(新品開發)，以及新興市場(低軌衛星)四大支柱
- 提供穩定且可預測的現金流，降低單一業務波動的風險



### 3. 技術與認證的雙重壁壘

- 高精度加工、獨特拋光與鈍化技術為難以複製的核心Know-How
- 同時擁有半導體設備維修與航太關鍵零組件製造等多項認證，構成技術與資格的雙重護城河

## ◆ 成長動能

# 驅動未來成長的四大引擎

我們將透過四大策略方向，持續提升市場滲透率、把握產業擴張機會並強化獲利能力

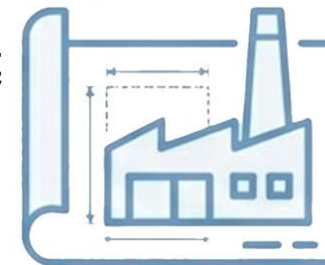
### 1. 提升半導體耗材滲透率

擴大高毛利耗材產品線，提高  
在既有客戶的市佔率



### 2. 深化新晶圓廠與先進製程合作

積極參與台積電等客戶的新建  
廠房專案，搶佔2奈米以下先  
進製程商機



### 3. 加速低軌衛星與測試設備業務

憑藉已取得的國際大廠認證，  
擴大航太低軌衛星與半導體測  
試設備市場的營收貢獻



### 4. 強化垂直整合與自製率

持續投資先進設備，提升關鍵  
製程自製率，縮短交期並創造  
差異化優勢





# Q&A

## 問答交流時間



感謝各位投資人與分析師撥冗參與本次法人說明會，科建國際深耕半導體與航太產業供應鏈多年，以技術創新與客戶關係為核心競爭力，掌握產業成長契機，我們期待與各位進行深入交流並解答您對公司營運、財務表現及未來策略之疑問